

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2021-078号

广东海川智能机器股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易标的公司估值较高风险：截止2021年6月30日，标的公司未经审计所有者权益为6,302.81万元，按照本次交易价格（标的公司估值约4.2亿）PB达到6.66倍，存在高额溢价，该项长期股权投资未来可能存在减值风险。

2、本次交易可能存在借款无法收回本息风险：公司本次拟向李睿提供的1亿元借款，拟由李睿直接持有标的公司部分股权质押给公司作为担保，并由李睿及标的公司提供连带责任；因公司目前尚未完全核实李睿个人的资产状况和偿还能力，若公司未行使换股权，到期要求李睿清偿借款时，可能存在质押标的股权的价值不足以清偿借款本息，或李睿及标的公司未能履行连带责任，本次借款有可能无法收回本息，存在一定的债务风险。

3、本次交易暂未设置业绩补偿条款风险：标的公司可能存在因业绩未达预期而导致公司长期股权投资减值，对公司利润产生不利影响。

4、标的公司经营活动产生的现金流量净额较低风险：标的公司两年及一期的经营活动产生的现金流量净额分别为326.96万元、-419.61万元和8.65万元，经营活动产生的现金流量净额较低，对标的公司正常的生产经营及持续发展可能产生不利影响。

5、标的公司财务数据未经审计和评估，相关事项存在不确定性风险：评估师、会计师正在开展评估和审计工作，截至目前未出具正式的评估报告和审计报告。

提请投资者关注以上提示，注意投资风险。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日收到深圳证券交易所发出的《关于对广东海川智能机器股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第405号）。

一、《关注函》主要内容

1. 公告1显示，李睿从间接持有标的公司股权变更为直接持有且达到控股地位，将其持有的部分标的公司股权质押给公司，在满足前述前提后的3个工作日内，公司向李睿提供1亿元的可换股借款。

(1) 请补充披露标的公司和芯通科技近三年股权结构变化，目前标的公司穿透后的股权结构；公司、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员与标的公司及其实际控制人李睿是否存在关联关系，是否会受让李睿间接持有标的公司的股权或与受让方存在关联关系。

(2) 请补充说明公司向李睿提供1亿元可换股借款的期限、利率、质押股权的估值方法，是否设置不换股情况下向李睿收回借款的时间、进度安排、违约责任等条款，相关条款在收回借款方面是否具有可实现性，是否存在向相关人员变相输送利益的情形，是否损害上市公司股东利益。

2. 公司于9月28日披露的《关于标的公司成都芯通软件有限公司财务数据补充披露的公告》（以下简称“公告2”）显示，标的公司近两年一期未经审计的所有者权益分别为4,255.94万元、4,835.02万元和6,302.81万元。请结合行业发展状况、标的公司主要资产构成、评估参数选取、未来盈利预测等详细说明标的公司股权评估的测算过程，评估增值较高的原因及合理性，并对评估增值较高充分提示风险。

请评估师核查并发表意见。

3. 公告2显示，标的公司近两年一期未经审计的营业收入分别为8,327.82万元、6,458.72万元和15,132.02万元，净利润分别为1,085.79万元、579.08万元和1,467.79万元，经营活动产生的现金流量净额分别为326.96万元、-419.61万元和8.65万元。2021年上半年应收账款期末余额为9,652.79万元，较期初余额2,965.01万元增幅较大。

(1) 请结合市场环境、销售政策、产品结构、销售数量、单价及成本费用变动等，核实2021年上半年收入是否满足确认条件，并说明标的公司2021年上半年营业收入和净利润大幅增长的原因及合理性。

(2) 请结合销售信用政策、应收账款周转天数、存货周转率变化等说明经

营活动现金流量净额与营业收入和净利润变动幅度不匹配的原因及合理性。

(3) 请结合近两年一期标的公司经营活动现金流量净额低的情况，补充说明未来业绩是否具有可持续性，是否影响估值，本次交易未设置业绩补偿条款的原因及合理性。

请会计师核查并发表意见。

4. 请结合标的公司的具体业务、经营模式、核心竞争力、业务成长性，与你公司主营业务关联性等情况，补充说明本次交易的原因及必要性。

5. 请补充说明标的公司管理团队情况，收购完成后管理团队稳定性，是否对关键管理人员存在重大依赖，是否签署必要的劳动协议、竞业禁止协议等。

二、公司就《关注函》事项回复如下：

问题1. 公告1显示，李睿从间接持有标的公司股权变更为直接持有且达到控股地位，将其持有的部分标的公司股权质押给公司，在满足前述前提后的3个工作日内，公司向李睿提供1亿元的可换股借款。

(1) 请补充披露标的公司和芯通科技近三年股权结构变化，目前标的公司穿透后的股权结构；公司、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员与标的公司及其实际控制人李睿是否存在关联关系，是否会受让李睿间接持有标的公司的股权或与受让方存在关联关系。

回复：

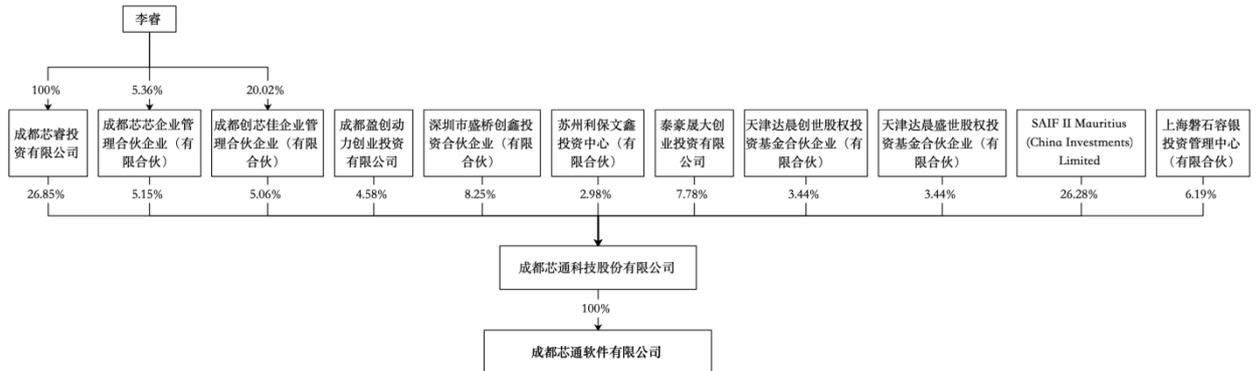
①标的公司和芯通科技近三年的股权结构变化

根据标的公司提供的工商档案，标的公司于2009年6月1日成立，成立时的唯一股东为“芯通科技(成都)有限公司”(成都芯通科技股份有限公司的曾用名)；2017年12月26日标的公司增加注册资本后，成都芯通科技股份有限公司(以下简称“芯通科技”)认缴标的公司3,000万元注册资本并全部实缴完毕，持有标的公司100%的股权，自本次增资后至今，标的公司的股权结构未发生过变化。

根据芯通科技提供的工商档案，芯通科技于2004年6月21日成立，自2016年3月2日芯通科技进行股权变更后至今，芯通科技的股权结构未发生过变化。

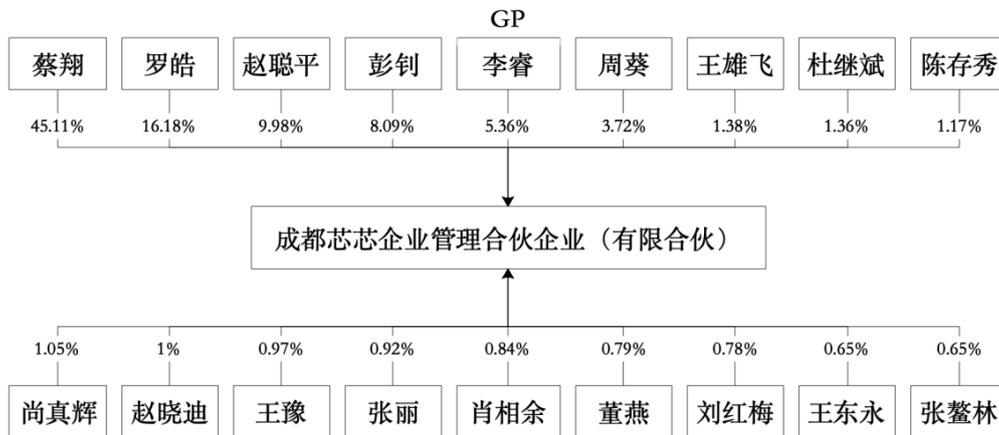
②目前标的公司穿透后的股权结构

根据标的公司的股权结构图，并经查询国家企业信用信息公示系统，截至查询日（2021年10月12日），标的公司的穿透后的股权结构如下：

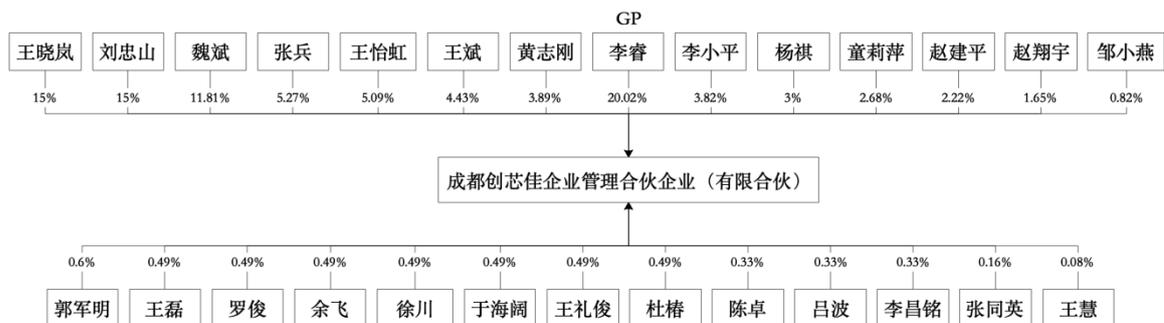


注：

上图中成都芯芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都芯芯”）穿透后的股权结构如下：



上图中成都创芯佳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都创芯佳”）穿透后的股权结构如下：



上图中，泰豪晟大创业投资有限公司为私募投资基金管理人并已完成私募投资基金管理人登记；深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）、上海磐石容银投资管理中心（有限合伙）、成都盈创动力创业投资有限公司、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州利保文鑫投资中心（有限合伙）均为私募投资基金，并已完成私募投资基金备案；SAIF II Mauritius(China Investments) Limited系在毛里求斯成立的境外股东，主要业务为风险投资。

③公司、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员与标的公司及其实际控制人李睿是否存在关联关系，是否会受让李睿间接持有标的公司的股权或与受让方存在关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，我们逐条对照了规则条款，认为标的公司及其实际控制人李睿不符合关联法人和关联自然人的规定条件，公司、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员与标的公司及其实际控制人李睿不存在关联关系。

根据前述标的公司穿透后的股权结构情况，李睿通过其控制的成都芯睿投资有限公司（以下简称“芯睿投资”）、成都芯芯和成都创芯佳间接持有芯通科技的股份，芯通科技直接持有标的公司100%股权，李睿由此间接持有标的公司的股权。本次交易中，不会有主体（即不存在公司、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员等主体）通过从李睿控制的芯睿投资、成都芯芯或成都创芯佳处受让芯通科技的股份，或通过从芯睿投资、成都芯芯和成都创芯佳的股东/合伙人处受让股权/合伙份额的方式，从而成为标的公司的间接股东；亦即，公司、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不会通过上述方式受让李睿间接持有标的公司的股权。

（2）请补充说明公司向李睿提供1亿元可换股借款的期限、利率、质押股权的估值方法，是否设置不换股情况下向李睿收回借款的时间、进度安排、违约责任等条款，相关条款在收回借款方面是否具有可实现性，是否存在向相关人员变相输送利益的情形，是否损害上市公司股东利益。

回复：

①公司向李睿提供1亿元可换股借款的期限、利率、质押股权的估值方法，是否设置不换股情况下向李睿收回借款的时间、进度安排、违约责任等条款

上市公司与成都芯通科技股份有限公司、李睿于2021年9月26日签订《合作意向协议》，协议约定“甲方拟在满足正式《投资协议》约定的款项出借前提下，向目标公司的实际控制人丙方提供人民币1亿元的可换股借款，获得针对目标公司无条件的换股权，即甲方有权（但无义务）按照正式《投资协议》约定的条件，向丙方购买其持有的目标公司股权”。

各方尚未签订正式《投资协议》，根据目前各方谈判沟通情况，拟定的相关条款内容如下：

A、各方拟在正式《投资协议》中设置不换股情况下向李睿收回借款的时间、进度安排、违约责任等条款。借款期限至以下两者中孰早者届满：上市公司要求行使换股权之日；2023年6月30日。

B、借款利率：若偿还借款，则按照年利率8%（单利）在还款时一次性支付；若上市公司行使换股权，则李睿无需向上市公司支付任何利息。

C、换股价格：参考届时专业评估机构出具的评估报告所评定的资产评估价值，由双方协商确定。

D、违约责任：在上市公司不选择进行换股情况下，若李睿违约未能归还相关借款，将采取执行强制追索措施及追加罚息的形式保障上市公司利益。

由于各方尚未签订正式《投资协议》，前述条款的具体内容存在不确定性，具体内容以最终签署的《投资协议》为准。

②相关条款在收回借款方面是否具有可实现性

若上市公司在协议规定的期限不行使换股权，则李睿须在协议规定的借款到期日偿还借款本金及利息。还款来源包括：芯通软件的未来分红；李睿持有的芯通软件股权价值折现以及李睿自身目前个人资产等。

为保障上市公司利益，本次借款拟采取以下增信措施：李睿将其持有的芯通软件部分股权（价值需覆盖可换股借款，具体价值将以评估价值为基础）质押予上市公司；李睿、芯通软件为本次可换股借款提供无限连带责任担保。

③是否存在向相关人员变相输送利益的情形，是否损害上市公司股东利益

本次交易以股权转让及可换股借款相结合方式的系上市公司看好芯通软件未来的发展。双方约定，本次交易的股权转让价格将参考专业评估机构出具的《评估报告》中的评估值，以低于评估值的价格进行交易，以保障上市公司利益。

同时，通过可换股借款方式，获得针对标的公司无条件的换股权，将根据未来标的公司的经营发展情况享有对标的公司未来追加投资的权利而不承担相关义务，更有利于上市公司的风险控制，增强本次交易的安全垫，不存在向相关人员变相输送利益的情形，不存在损害上市公司股东利益的情形。

问题2. 公司于9月28日披露的《关于标的公司成都芯通软件有限公司财务数据补充披露的公告》（以下简称“公告2”）显示，标的公司近两年一期未经审计的所有者权益分别为4,255.94万元、4,835.02万元和6,302.81万元。请结合行业发展状况、标的公司主要资产构成、评估参数选取、未来盈利预测等详细说明标的公司股权评估的测算过程，评估增值较高的原因及合理性，并对评估增值较高充分提示风险。

请评估师核查并发表意见。

回复：

截至本回复出具日，评估师尚未完成相关工作，亦未出具正式的评估报告，根据初步了解调查到的情况分析回复如下：

（1）行业发展状况

标的公司是射频技术和服务提供商，广泛应用于移动通讯、医疗和物联网解决方案三大领域。在移动通讯领域，标的公司主要提供无线接入远端射频单元、功率放大器等产品，主要应用于多应用场景的基站建设；在医疗领域，标的公司

主要提供MRI超大功率射频功率放大模组等产品，应用于医疗核磁成像；在物联网解决方案领域，标的公司主要提供机器数据可视化采集系统软硬件方案。

1) 基站建设

无线基站分为4类，分别是宏基站、微基站、皮基站和飞基站；微基站、皮基站和飞基站，通常合称小基站或小站。无线基站主要划分依据是功率和容量，分类如下：

分类	英文	别称	单载波功率 (20Hz 带宽)	同时接入用户 数	覆盖范围	应用场景
宏基站	Macro Site	宏站	10W 以上	1000 个以上	200m	室外
小 基 站	微基站	Micro Site	0.5-10W	128-512 个	50-200m	高铁站、机场、 大商场等
	皮基站	Pico Site	0.1-0.5W	64-128 个	20-50m	写字楼、工业园 区等
	飞基站	Femto Site	0.1W 以下	8-16 个	10-20m	家庭、咖啡馆等

根据工信部统计，截至2020年底，全国移动电话基站总数达931万站。其中，4G基站总数达到575万站，城镇地区实现深度覆盖；5G网络建设稳步推进，累计开通71.8万站，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。截至2021年6月末，我国移动通信基站总数达948万站。其中，4G基站总数为584万站，占比为61.6%；5G基站总数96.1万站，我国已开通5G基站数量全球排名第一。

2021年上半年，我国移动通信基站总数比上年末净增17万站。由于芯片短缺，我国的5G建设进度已经被拖慢，下半年建设节奏有望恢复，预计2021年全年电信运营商将建设超过80万站5G基站。

截至2021年上半年，我国4G基站总数为584万站（其中宏站400万站、小站184万站）；按照中低频段的宏站可实现与4G基站相当的覆盖范围，预计5G宏站数量将是4G宏站的1.2倍，即480万站；小站应用于热点区域或更高容量业务场景，其数量保守估计将是宏站的2倍，预计5G小站数量将达到960万站；即宏基站和小基站新建数量合计达到1,440万站。

2) 医疗射频

标的公司基于固态放大器件，相比真空电子管器件的高智能化、高集成和高可靠性优势，通过频率合成、大功率合成、宽带高线性功放技术，提供全制式的

功率放大器、耦合器、双功器等射频微波产品。广泛用于工业射频和医疗射频行业，助力大型智能设备升级换代。

标的公司结合多年在通信射频技术的积累，成功研发了系列 MR 射频功率放大器，是国内领先的具备 MR 射频产业化能力的厂商，产品主要用于核磁共振成像检查设备中，客户为美国通用电气。核磁共振成像检查设备长期被 GPS（通用电气、飞利浦、西门子）垄断，受新冠肺炎疫情影响，客户对该类产品需求有所降低，但随着疫情的缓解及终止，预计未来年度将逐步恢复，通过新增客户带来增量业务。未来发展空间预计将超过前期高点并保持一定增长。

（2）标的公司主要资产构成

近两年随着标的公司业务规模的扩张，资产总额稳步增长，资产结构较为稳定。2021年6月30日，标的公司各类资产结构及变动情况如下表所示：

项目	2021年6月30日	
	金额（万元）	比例（%）
流动资产	16,221.73	91.94
非流动资产	1,421.15	8.06
合计	17,642.88	100

流动资产主要为货币资金、应收票据及应收账款、预付账款、其他应收款、存货等构成，占总资产比重在90%以上，货币资金、应收账款、存货占流动资产的比例较大。非流动资产主要为固定资产、无形资产、开发支出、长摊费用等，占总资产比重不足10%，资产结构主要受标的公司的生产经营模式决定，标的公司生产模式上主要负责产品的研发与工艺设计，产品的生产制造及组装则通过外协加工，主要设备也均为研发、测试相关的机器设备及电子设备、夹具等辅助设备，标的公司的非流动资产占总资产比例较小，即标的公司为轻资产类型的企业。企业的账面未记录的相关专利、软件著作权等情况如下：

1) 专利

标的公司已取得的无形资产专利明细如下：

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日	保护期限	取得方式
1	芯通软件	一种 PCB 金属片结构和 PCB 板部件	实用新型	202022812025.5	2021/8/31	10 年	原始取得
2	芯通软件	一种 TDD 功放控制电路	实用新型	202022772020.4	2021/1/29	10 年	原始取得
3	芯通	一种用于 HFC 传输设备的过流防雷电	实用	202022708034.X	2021/8/31	10 年	原始

	软件	路及其 HFC 传输设备	新型				取得
4	芯通软件	一种 5G 小站内置全向天线	实用新型	202022633390. X	2021/1/29	10 年	原始取得
5	芯通软件	一种用于 5G 微基站的快锁安装组件	实用新型	202021850700. 7	2021/6/4	10 年	原始取得
6	芯通软件	一种用于 5G 微基站的多功能安装组件	实用新型	202021854524. 4	2021/6/4	10 年	原始取得
7	芯通软件	一种用于 5G 微基站内滤波器的出线保护结构和滤波器	实用新型	202021848064. 4	2021/1/29	10 年	原始取得
8	芯通软件	一种 PCB 板的阻焊网以及 PCB 板	实用新型	201922171857. 0	2020/9/22	10 年	原始取得
9	芯通软件	多频段 HFC 设备输出电平可自动调谐的补偿系统及方法	发明专利	201911180751. 5	2021/8/31	20 年	原始取得
10	芯通软件	一种 LTE 双频天线	实用新型	201921469168. 1	2020/4/28	10 年	原始取得
11	芯通软件	一种 HFC 放大器多路端口输出一致性校准方法	发明专利	201910697384. X	2021/1/29	20 年	原始取得
12	芯通软件	皮基站终端（5G）	外观设计	201930314491. 0	2020/2/14	10 年	原始取得
13	芯通软件	一种射频信号分段均衡电路及射频信号传输设备	实用新型	201820969802. 7	2019/1/8	10 年	原始取得
14	芯通软件	一种 HFC 放大器多频段兼容电路及 HFC 放大器	实用新型	201820974872. 1	2018/12/21	10 年	原始取得
15	芯通软件	一种射频衰减插片等效衰减控制电路	实用新型	201820228430. 2	2018/9/28	10 年	受让取得
16	芯通软件	一种 HFC 放大器输出端口一致性校准方法	发明专利	201711394389. 2	2021/1/29	20 年	原始取得
17	芯通软件	一种金属焊接结构及焊接基片	实用新型	201721782985. 3	2018/7/6	10 年	原始取得
18	芯通软件	一种功能模块散热结构及机箱	实用新型	201721781741. 3	2018/7/6	10 年	原始取得
19	芯通软件	一种 HFC 机械衰减插片焊接结构及焊接基座	实用新型	201721781743. 2	2018/7/6	10 年	原始取得
20	芯通软件	一种平面巴伦	实用新型	201721782218. 2	2018/7/6	10 年	原始取得
21	芯通软件	一种混频板测试装置及测试设备	实用新型	201721783889. 0	2018/7/6	10 年	原始取得
22	芯通软件	一种自适应抱箍安装装置及紧固方法	发明专利	201711070344. X	2019/7/9	20 年	受让取得
23	芯通软件	一种 PCB 电路板信号单元的屏蔽结构	实用新型	201721455393. 0	2018/9/28	10 年	受让取得
24	芯通软件	光通信模块	外观设计	201730537645. 3	2018/5/29	10 年	受让取得
25	芯通软件	PCB 信号单元屏蔽接地装置	发明专利	201711070345. 4	2020/3/31	20 年	受让取得
26	芯通软件	一种电子元器件接地单元	实用新型	201721454897. 0	2018/6/19	10 年	受让取得
27	芯通软件	PCB 电路板的屏蔽盖及安装箱	实用新型	201721454896. 6	2018/6/19	10 年	受让取得
28	芯通软件	电子元器件接地装置及接地方法	发明专利	201711072324. 6	2019/9/6	20 年	受让取得
29	芯通软件	自适应抱箍	实用新型	201721453740. 6	2018/5/29	10 年	受让取得
30	芯通软件	电子元器件防脱落结构及双工器防脱落装置	实用新型	201721455392. 6	2018/5/4	10 年	受让取得
31	芯通软件	通信模块	外观设计	201730329975. 3	2017/12/15	10 年	受让取得

32	芯通软件	户外通信机箱	外观设计	201730330006.X	2017/12/15	10年	受让取得
33	芯通软件	一种连接器芯针过孔屏蔽装置	实用新型	201621448077.6	2017/6/20	10年	受让取得
34	芯通软件	一种电路板接地保护装置	实用新型	201621446581.2	2017/7/21	10年	受让取得
35	芯通软件	一种电路系统定位安装装置及机箱	实用新型	201621448075.7	2017/6/20	10年	受让取得
36	芯通软件	一种旋转定位装置	实用新型	201621447368.3	2017/7/4	10年	受让取得
37	芯通软件	一种PCB电路板散热装置及机箱	发明专利	201611227589.4	2019/9/6	20年	受让取得
38	芯通软件	一种PCB电路板的电源散热装置及机箱	实用新型	201621447369.8	2017/6/20	10年	受让取得
39	芯通软件	一种电容式距离测量方法、装置及其定标方法	发明专利	201610652008.5	2019/4/12	20年	受让取得
40	芯通软件	一种用于功放的预失真装置及其参数选择方法	发明专利	201610652841.X	2019/4/12	20年	受让取得
41	芯通软件	一种移相全桥变换电路及控制方法	发明专利	201410121079.3	2017/7/28	20年	受让取得
42	芯通软件	一种组合型射频功放测试用开关矩阵	发明专利	201310737356.9	2015/5/13	20年	受让取得
43	芯通软件	6路射频大功率合成器	发明专利	201310740452.9	2016/2/10	20年	受让取得
44	芯通软件	一种用于射频产品测试的射频开关矩阵	发明专利	201310007137.5	2016/5/11	20年	受让取得
45	芯通软件	一种数字飞地压扩系统及其时延同步方法	发明专利	201110447326.5	2015/10/21	20年	受让取得
46	芯通软件	一种数字飞地系统及其链路增益平衡方法	发明专利	201110447336.9	2015/7/1	20年	受让取得
47	芯通软件	一种数字飞地系统	发明专利	201110444237.5	2014/4/23	20年	受让取得
48	芯通软件	一种基于两段式的直放站自动定标校准方法及系统	发明专利	201110445210.8	2013/11/6	20年	受让取得
49	芯通软件	一种射频传输TDD开关信号的方法与装置	发明专利	201110421924.5	2015/3/4	20年	受让取得
50	芯通软件	一种提高耦合方向性的电路及方法	发明专利	201110333974.8	2014/2/26	20年	受让取得
51	芯通软件	一种数字预失真装置及方法	发明专利	201010534332.X	2014/6/11	20年	受让取得
52	芯通软件	一种功放模块栅压自动补偿装置及方法	发明专利	201010291927.7	2012/5/16	20年	受让取得
53	芯通软件	一种适用于射频模块产品测试可灵活扩展的自动测试系统平台	发明专利	201010155835.6	2013/2/27	20年	受让取得
54	芯通软件	一种射频模块功放通用调试接口的实现方法	发明专利	201010155816.3	2012/7/25	20年	受让取得
55	芯通软件	一种射频模块离线参数通用校准接口的实现方法	发明专利	201010155844.5	2012/10/3	20年	受让取得
56	芯通软件	一种仪器模块通用接口的实现方法	发明专利	200910312936.7	2013/1/2	20年	受让取得
57	芯通软件	射频传输系统的定向耦合方法及耦合器	发明专利	200910265020.0	2013/7/17	20年	受让取得
58	芯通软件	一种低射频阻抗测量装置	发明专利	200910308560.2	2012/7/4	20年	受让取得
59	芯通软件	一种功率放大器栅压控制方法及系统	发明专利	200910167614.8	2012/1/25	20年	受让取得
60	芯通	一种自适应调整CFR门限的方法及射	发明	200910059405.1	2012/8/29	20年	受让

	软件	频拉远系统	专利				取得
61	芯通软件	一种安全远程升级嵌入式 Linux 内核的方法及装置	发明专利	200910302553.1	2012/1/25	20年	受让取得
62	芯通软件	对 TD-SCDMA 射频拉远单元的生产测试方法	发明专利	200810148111.1	2013/1/23	20年	受让取得
63	芯通软件	一种 TD-SCDMA 射频拉远单元的天线自校准方法及电路	发明专利	200810148076.3	2012/7/25	20年	受让取得
64	芯通软件	一种数字 Doherty 功率放大器	发明专利	200810148068.9	2012/1/25	20年	受让取得
65	芯通软件	对 TD-SCDMA 多通道射频拉远单元天线系统的检测方法	发明专利	200810147672.X	2010/6/30	20年	受让取得
66	芯通软件	一种实现 TD-SCDMA 直放站稳定同步的方法及系统	发明专利	200810044785.7	2012/5/23	20年	受让取得
67	芯通软件	具有高抗干扰能力的 TD-SCDMA 直放站同步方法及装置	发明专利	200810044642.6	2013/3/27	20年	受让取得
68	芯通软件	多通道数字预失真处理装置及预失真处理方法	发明专利	200810044447.3	2012/6/13	20年	受让取得
69	芯通软件	多载波智能天线校准中频处理方法和装置	发明专利	200810044412.X	2012/8/29	20年	受让取得
70	芯通软件	一种新型智能天线及实现方法	发明专利	200810045060.X	2013/7/10	20年	受让取得
71	芯通软件	TD-SCDMA 移动通信系统使用分集接收和发射的装置和方法	发明专利	200710050616.X	2012/10/3	20年	受让取得
72	芯通软件	TD-SCDMA 基站微波拉远集成收发射机	发明专利	200710050253.X	2012/11/14	20年	受让取得
73	芯通软件	皮基站的设计方法和装置	发明专利	200710049413.9	2012/7/4	20年	受让取得
74	芯通软件	TD-SCDMA 系统的中继放大方法及装置	发明专利	200610022401.2	2009/8/19	20年	受让取得
75	芯通软件	TD-SCDMA 基站中频拉远子系统的传输方法	发明专利	200610021793.0	2009/1/14	20年	受让取得
76	芯通软件	TD-SCDMA 系统基站射频数字拉远的光纤传输方法和装置	发明专利	200610020350.X	2009/8/26	20年	受让取得
77	芯通软件	无线通信基站/收发信机的环形连接方法及中频接口结构	发明专利	200510021908.1	2008/4/2	20年	受让取得
78	芯通软件	基站设备实现射频拉远的中频传输方法及中频接口	发明专利	200510001653.2	2008/7/2	20年	受让取得

2) 软件著作权

标的公司的无形资产软件著作权明细如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表日期	开发完成日期	登记日期	取得方式
1	芯通软件	5G 室内两通道有源小微基站射频拉远单元软件（嵌入式）	2021SR0867435	2021/4/9	2021/4/8	2021/6/9	原始取得
2	芯通软件	5G 室内四通道有源小微基站射频拉远单元软件（嵌入式）	2021SR0867436	2021/4/20	2021/4/16	2021/6/9	原始取得
3	芯通软件	室内有源小微基站射频拉远单元（pRRU）软件（嵌入式）	2020SR1808799	2020/9/21	2020/6/10	2020/12/14	原始取得
4	芯通软件	芯通 N02 智能测试系统	2020SR0105072	2018/10/8	2018/10/8	2020/1/20	原始取得

5	芯通软件	芯通 M 型手机信息采集系统（嵌入式）	2019SR0335652	2018/10/8	2018/10/8	2019/4/16	原始取得
6	芯通软件	芯通 S 型手机信息采集系统（嵌入式）	2019SR0335636	2018/10/8	2018/10/8	2019/4/16	原始取得
7	芯通软件	全频段智能屏蔽系统软件（嵌入式）	2018SR1005696	2018/5/16	2018/3/30	2018/12/12	原始取得
8	芯通软件	芯通地空通信功放模块软件（嵌入式）	2018SR1005700	2018/6/10	2018/5/10	2018/12/12	原始取得
9	芯通软件	芯通室内小功率全频段手机信息采集系统（嵌入式）	2018SR1005810	2018/10/8	2018/10/8	2018/12/12	原始取得
10	芯通软件	芯通机载终端系统软件（嵌入式）	2018SR1005616	2018/5/10	2018/5/10	2018/12/12	原始取得
11	芯通软件	芯通 Band48 smallcell 功率放大器软件（嵌入式）	2018SR1007401	2018/7/10	2018/5/10	2018/12/12	原始取得
12	芯通软件	芯通下一代双边（机械式）混频软件（嵌入式）	2018SR311886	2018/3/19	2018/3/19	2018/5/8	原始取得
13	芯通软件	芯通机械式混频胆控制软件（嵌入式）	2018SR061381	2017/11/13	2017/11/2	2018/1/25	原始取得
14	芯通软件	Tespeed 智慧工厂管理平台	2017SR659827	2017/11/10	2017/11/1	2017/12/1	原始取得
15	芯通软件	芯通 QZ0101Z13 系统软件（嵌入式）	2017SR624465	2017/6/16	2017/6/12	2017/11/14	原始取得
16	芯通软件	芯通智能制造大数据管理平台	2017SR211847	2017/3/31	2017/3/2	2017/5/26	原始取得
17	芯通软件	芯通自动化控制系统	2017SR211827	2017/2/17	2017/1/16	2017/5/26	原始取得
18	芯通软件	芯通混频胆控制软件（嵌入式）	2016SR321859	2016/8/19	2016/8/8	2016/11/8	原始取得
19	芯通软件	芯通 PLD442Z7 模块软件（嵌入式）	2016SR058464	2016/1/22	2016/1/15	2016/3/21	原始取得
20	芯通软件	芯通 PLJ401Z7 模块目标程序（嵌入式）	2016SR039426	2015/12/15	2015/12/11	2016/2/26	原始取得
21	芯通软件	芯通 N16 研发/制造管理平台软件	2016SR002354	2010/9/20	2010/8/8	2016/1/5	原始取得
22	芯通软件	芯通 H1-1510GE 软件（嵌入式）	2015SR261189	2015/11/10	2015/10/10	2015/12/15	原始取得
23	芯通软件	芯通 G200WOR 飞地系统远端机软件（嵌入式）	2015SR205924	2012/5/4	2011/3/31	2015/10/26	原始取得
24	芯通软件	芯通 G200WOL 飞地系统近端机软件（嵌入式）	2015SR205915	2012/5/4	2011/3/31	2015/10/26	原始取得
25	芯通软件	芯通 QN017HWG 混频板控制程序（嵌入式）	2015SR193602	2015/5/20	2015/5/10	2015/10/10	原始取得
26	芯通软件	芯通 PF0501GP 模块软件（嵌入式）	2015SR193433	2015/9/10	2015/9/10	2015/10/9	原始取得

27	芯通软件	芯通 QF003AK 激励器系统软件（嵌入式）	2015SR193431	2015/9/1	2015/9/1	2015/10/9	原始取得
----	------	-------------------------	--------------	----------	----------	-----------	------

注：软件著作权有效期截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，相关法律不再保护。

（3）初步估值分析

行业估值水平如下：

序号	代码	简称	市盈率 PE
			TTM
平均值			35.81
中位数			33.90
1	000063	中兴通讯	24.48
2	300308	中际旭创	28.96
3	300502	新易盛	27.53
4	002281	光迅科技	28.10
5	002396	星网锐捷	29.11
6	300394	天孚通信	34.19
7	002194	武汉凡谷	33.90
8	002897	意华股份	51.71
9	002792	通宇通讯	49.74
10	300548	博创科技	39.70
11	300710	万隆光电	52.73
12	300570	太辰光	47.35
13	688668	鼎通科技	34.19
14	002296	辉煌科技	23.69
15	688618	三旺通信	31.74

数据来源：同花顺 iFinD

从上面数据可见，通信行业PE-TTM中位数为33.90倍。按标的公司2020年7月至2021年6月连续12个月净利润合计约为2,248.74万元，结合行业PE-TTM水平及参照一定的流动性折扣（35%-45%），则标的公司采用相对估值法估值区间约为4.2-5.0亿。

相对估值法主要参照历史数据并结合了市场对行业的预期，最终估值需以绝对估值法的收益法作为最终结论，由于目前标的企业历史数据尚在审计过程中，标的企业管理层也尚在盈利预测的测算过程中，之后盈利预测尚需评估师进行复核验证及评估机构进行内部审核，故目前阶段暂无法提供未来盈利预测数据。

（4）预估增值原因

1) 标的企业拥有核心技术

标的公司注重核心技术的积累和研发，拥有47项发明专利、27项实用新型专利和4项外观设计专利，内部总结了数百项“货架技术”，其涵盖范围包括射频功放、基带信号处理、测试系统、生产工艺等领域。

标的公司拥有的核心技术包括高效率相关功率放大器技术、数字削峰(CFR)及数字预失真技术、射频产品工艺技术。

2) 主营业务所处市场具有成长性

标的公司业务具有良好的成长性，原因主要在于当前室内基站建设增长，全国基站建设全面提速，基站射频行业的市场规模将迎来新一轮的高增长期，标的公司通讯板块业务有望实现较快增长。

评估师已正式进场芯通软件开展评估工作，截至目前尚未完成相关工作，亦未出具正式的评估报告，公司暂时无法披露中介机构的核查意见，待评估报告正式出具后，公司将对相关内容进行补充。

风险提示：本次交易存在标的公司估值较高的风险（截止2021年6月30日，标的公司未经审计所有者权益为6,302.81万元，如按相对估值法下预估增值率为566.26%-693.30%），提请投资者注意投资风险。

问题3. 公告2显示，标的公司近两年一期未经审计的营业收入分别为8,327.82万元、6,458.72万元和15,132.02万元，净利润分别为1,085.79万元、579.08万元和1,467.79万元，经营活动产生的现金流量净额分别为326.96万元、-419.61万元和8.65万元。2021年上半年应收账款期末余额为9,652.79万元，较期初余额2,965.01万元增幅较大。

（1）请结合市场环境、销售政策、产品结构、销售数量、单价及成本费用变动等，核实2021年上半年收入是否满足确认条件，并说明标的公司2021年上半年营业收入和净利润大幅增长的原因及合理性。

(2) 请结合销售信用政策、应收账款周转天数、存货周转率变化等说明经营活动现金流量净额与营业收入和净利润变动幅度不匹配的原因及合理性。

(3) 请结合近两年一期标的公司经营活动现金流量净额低的情况，补充说明未来业绩是否具有可持续性，是否影响估值，本次交易未设置业绩补偿条款的原因及合理性。

请会计师核查并发表意见。

截至本回复出具日，会计师尚未完成相关工作，亦未出具正式的审计报告，公司根据初步了解调查到的情况分析回复如下：

(1) 请结合市场环境、销售政策、产品结构、销售数量、单价及成本费用变动等，核实2021年上半年收入是否满足确认条件，并说明标的公司2021年上半年营业收入和净利润大幅增长的原因及合理性。

回复：

标的公司是射频技术和服务提供商，广泛应用于移动通讯、医疗和物联网解决方案三大领域。在移动通讯领域，标的公司主要提供无线接入远端射频单元、功率放大器等产品，主要应用于多应用场景的基站建设；在医疗领域，标的公司主要提供MRI超大功率射频功率放大模组等产品，应用于医疗核磁成像；在物联网解决方案领域，标的公司主要提供机器数据可视化采集系统软硬件方案。受益于行业发展，2021年1-6月，标的公司通讯产品收入大幅增长，带动营业收入和净利润大幅增长，具有合理性。具体如下：

1) 市场环境

根据工信部统计，截至2020年底，全国移动电话基站总数达931万站。其中，4G基站总数达到575万站，城镇地区实现深度覆盖；5G网络建设稳步推进，累计开通71.8万站，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。截至2021年6月末，我国移动通信基站总数达948万站。其中，4G基站总数为584万站，占比为61.6%；5G基站总数96.1万站，我国已开通5G基站数量全球排名第一。

2021年上半年,我国移动通信基站总数比上年末净增17万站。由于芯片短缺,我国的5G建设进度已经被拖慢,下半年建设节奏有望恢复,预计2021年全年电信运营商将建设超过80万站5G基站。

截至2021年上半年,我国4G基站总数为584万站(其中宏站400万站、小站184万站);按照中低频段的宏站可实现与4G基站相当的覆盖范围,预计5G宏站数量将是4G宏站的1.2倍,即480万站;小站应用于热点区域或更高容量业务场景,其数量保守估计将是宏站的2倍,预计5G小站数量将达到960万站;即宏基站和小基站新建数量合计达到1,440万站。

受益于室内基站建设增长,标的公司2021年业务出现大幅增长。

2) 标的公司收入增长情况

标的公司近两年一期主营业务收入、主要产品结构情况如下表所示:

金额单位:人民币元

细分类别	2019年					
	销售收入	销售成本	数量	平均价格	平均成本	毛利率
医疗产品	50,630,327.66	28,504,794.76	6,245.00	8,107.34	4,564.42	43.70%
通信产品	13,277,453.23	10,287,422.52	3,773.00	3,519.07	2,726.59	22.52%
物联网解决方案及产品	11,729,905.32	6,441,062.57	609.00	19,260.93	10,576.46	45.09%
软件及服务	5,831,617.91	233,955.21	3,041.00	1,917.66	76.93	95.99%
合计	81,469,304.12	45,467,235.06				44.19%

金额单位:人民币元

细分类别	2020年					
	销售收入	销售成本	数量	平均价格	平均成本	毛利率
医疗产品	28,084,565.08	16,534,856.82	3,845.00	7,304.18	4,300.35	41.12%
通信产品	14,664,614.03	8,778,529.21	3,296.00	4,449.22	2,663.39	40.14%
物联网解决方案及产品	14,372,695.96	8,766,684.11	1,415.00	10,157.38	6,195.54	39.00%
软件及服务	6,028,531.15	184,015.05	2,514.00	2,397.98	73.20	96.95%
合计	63,150,406.22	34,264,085.19				45.74%

金额单位:人民币元

细分类别	2021年上半年					
	销售收入	销售成本	数量	平均价格	平均成本	毛利率
医疗产品	13,879,785.04	8,190,555.40	2,234.00	6,212.97	3,666.32	40.99%

通信产品	110,714,318.91	98,335,181.07	41,871.00	2,644.18	2,348.53	11.18%
物联网解决方案及产品	16,769,265.85	10,310,252.33	1,833.00	9,148.54	5,624.80	38.52%
软件及服务	8,440,026.73	481,837.77	4,470.00	1,888.15	107.79	94.29%
合计	149,803,396.53	117,317,826.57				21.69%

标的公司2021年上半年收入增长主要系该期间室内小基站建设的增长而带动的通信产品收入的迅猛增长，其收入和利润的大幅增长有行业发展的背景。

3) 收入满足确认条件

对于2021年上半年收入确认是否满足条件，标的公司按照合同履约义务将产品交付给购货方，取得客户的签收单、报关单等凭据，在重要客户的系统中也能查询到商品收货的确认记录及销售发票的确认记录，且产品销售金额已确定、相关成本能够可靠地计量，满足收入确认的条件。

(2) 请结合销售信用政策、应收账款周转天数、存货周转率变化等说明经营活动现金流量净额与营业收入和净利润变动幅度不匹配的原因及合理性。

回复：

标的公司销售信用政策在2021年上半年未发生大的变动，与2020年信用政策基本保持一致。

标的公司及同行业可比公司经营活动产生的现金流量净额与营业收入、净利润变动幅度之间的差异具体分析如下：

金额单位：人民币万元

公司	2021年1-6月					
	营业收入		净利润		经营活动产生的现金流量净额	
	金额	变动比例	金额	变动比例	金额	变动比例
三维通信	521,587.44	32.85%	2,683.90	190.18%	-27,664.70	-425.55%
大富科技	105,213.25	-6.10%	-1,537.98	-137.69%	8,028.43	16.08%
世嘉科技	68,956.00	-21.90%	-1,490.93	-138.67%	-765.68	92.16%
欣天科技	12,363.17	15.05%	438.14	-4.83%	-39.22	-102.28%
标的公司	15,132.02	564.91%	1,467.79	575.72%	8.65	-96.97%

金额单位：人民币万元

公司	2020年					
	营业收入		净利润		经营活动产生的现金流量净额	
	金额	变动比例	金额	变动比例	金额	变动比例

三维通信	873,805.42	57.19%	261.08	-98.49%	66,334.65	-14.89%
大富科技	218,554.61	-6.50%	5,951.55	116.75%	15,758.61	-72.99%
世嘉科技	164,094.59	-12.31%	4,207.14	-61.85%	4,040.24	-85.22%
欣天科技	22,482.76	-2.01%	494.88	-70.80%	3,922.69	31.06%
标的公司	6,458.72	-22.44%	579.08	-46.67%	-419.61	-228.34%

应收账款周转天数及存货周转率方面：

公司	存货周转率		应收账款周转天数	
	2021年 1-6月	2020年	2021年 1-6月	2020年
三维通信	15.40	30.64	29.99	30.71
大富科技	1.75	3.69	105.66	106.92
世嘉科技	2.88	6.68	60.51	54.20
欣天科技	1.97	3.96	144.58	161.81
标的公司	4.45	2.22	73.70	156.15

由上数据可知：同行业上市公司，经营活动产生的现金流量净额与营业收入、净利润变动幅度均存在一定不匹配的现象，标的公司主要从事以无线通信与射频技术为主的产品的研发、生产、销售及服务，所在行业存在上下游付款周期不同的情况。因此经营活动产生的现金流量净额与营业收入、净利润变动幅度不匹配存在一定合理性。

(3) 请结合近两年一期标的公司经营活动现金流量净额低的情况，补充说明未来业绩是否具有可持续性，是否影响估值，本次交易未设置业绩补偿条款的原因及合理性。

回复：

标的公司经营活动现金流量净额低的原因主要系标的公司通讯产品所处行业面临重要发展机遇，标的公司一方面加紧国内外市场开拓，另一方面加大研发投入，致使标的公司经营活动现金流量净额较低。

标的公司未来业绩具有可持续性，原因主要在于当前室内基站建设增长，全国基站建设全面提速，基站射频行业的市场规模将迎来新一轮的高增长期，标的公司通讯板块业务有望实现较快增长。

目前为止与标的公司的合作仅签订了《意向合作协议》、尚处于初步阶段，具体条款待正式协议确定。另公司仅系财务投资人故暂未设置业绩补偿条款。

会计师已正式进场芯通软件开展审计工作，截至目前尚未完成相关工作，亦未出具正式的审计报告，公司暂时无法披露中介机构的核查意见，待审计报告正式出具后，公司将对相关内容进行补充。

问题4. 请结合标的公司的具体业务、经营模式、核心竞争力、业务成长性，与你公司主营业务关联性等情况，补充说明本次交易的原因及必要性。

回复：

(1) 标的公司的业务情况

标的公司是射频技术和服务提供商，广泛应用于移动通讯、医疗和物联网解决方案三大领域。在移动通讯领域，标的公司主要提供无线接入远端射频单元、功率放大器等产品，主要应用于多应用场景的基站建设；在医疗领域，标的公司主要提供MRI超大功率射频功率放大模组等产品，应用于医疗核磁成像；在物联网解决方案领域，标的公司主要提供机器数据可视化采集系统软硬件方案。

芯通软件主要产品情况如下：

类别	产品名称	产品介绍	应用领域
通信产品	开放式射频拉远系统	射频拉远系统是移动通信中最重要的单元，可独立安装在铁塔 /杆/墙等室内外环境，通过开放接口技术将基站端基带数字信号转换为射频并进行高效率线性放大，通过天发射以实现无信号的广域覆盖。	适用于无线通信运营商、主设备商安装无线设备所有应用场景
	一体化基站	集成数字基带和射频拉远系统，满足行业应用的轻量化部署	
	高效数字直放站	高效数字直放站具有中继距离远和建站速度快的突出优点，可用于通信信号覆盖、数据回传与监控、应急通信，有效解决复杂地形的信号覆盖问题和降低特殊场景的数据回传成本问题。	偏远地区等复杂地形区域的通信覆盖和特殊场景的监控领域
医疗产品	MR 射频功率放大器	MR 射频功率放大器将前端送来的微弱脉冲序列信号放大到足够功率去驱动发射线圈，从而产生磁共振成像需要的磁场，用于磁共振成像。该产品具有效率高、可靠性好、使用方便的优点，主要技术指标已达到国际先进水平。	0.3T-3T 医疗 MR 设备

	MR 前置放大器	MR 前置放大器是一种应用于MR 磁共振成像系统接收链路的宽动态低噪声射频放大器，用于放大接收线圈检测到的人体在受到发射磁场激励后发出的微弱 MR 信号。本产品是通信技术与 MR 具体应用结合的产物，其关键技术指标达到国际先进水平。	-
物联网解决方案	机器数据可视化采集系统	通过网络空口关键性数据进行分析采集，并回传至后台进行快速、实时存储运算，能够与多数据源进行融合分析。	平安城市与公共安全管理
软件及服务	M3 智能制造集中管理平台	M3 智能制造集中管理平台针对产品测试复杂、仪表多数据量大的特点，融入泛型测试理念，应用虚拟仪器技术、脚本引擎技术，通用驱动技术，专注于为复杂电子产品在工艺、测试制造和质量领域提供整体智能解决方案。	大型射频设备制造商

标的公司采取定制化生产模式，负责产品的研发与工艺设计，而产品的制造、组装主要通过委托外加工的方式完成，所有产品的加工通过标的公司拥有自主知识产权的智能制造集中管理平台进行控制与管理。

具体来说，客户根据需求向标的公司提交订单，标的公司根据订单产品进行研发设计，研发设计样品由客户端进行验收，验收合格后，委托加工厂商按标的公司提供的产品设计图进行生产；同时标的公司对需要的原材料进行采购；委托外加工厂商完成生产产品贴装和后续成品组装及测试，同时根据标的公司的指令，发回至标的公司，由标的公司进行产品的测试验收，或直接发给客户。

标的公司注重核心技术的积累和研发，拥有47项发明专利、27项实用新型专利和4项外观设计专利，内部总结了数百项“货架技术”，其涵盖范围包括射频功放、基带信号处理、测试系统、生产工艺等领域。标的公司拥有的核心技术包括高效率相关功率放大器技术、数字削峰（CFR）及数字预失真技术、射频产品工艺技术等。

标的公司业务具有良好的成长性，原因主要在于当前室内基站建设增长，全国基站建设全面提速，基站射频行业的市场规模将迎来新一轮的高增长期，标的公司通讯板块业务有望实现较快增长。

(2) 与上市公司主营业务的关联性

上市公司是国际知名专业自动化称重计量设备生产制造企业，拥有完整的研发、制造、销售和服务体系，致力于提供专业化、高性能的计量称重设备和解决方案。标的公司专注于通讯基站射频产品的研制与产业化，是全球领先的射频技术和服务提供商。

标的公司从事业务与上市公司主营业务不存在直接的关联性。上市公司在智能衡器领域深耕多年，拥有丰富的行业资源，拟通过本次合作，借助上市公司平台融资渠道优势，以及公司其他资源优势，达成双方的战略协作、技术交流、资源共享，紧抓行业发展机遇，实现上市公司与标的公司的快速发展。

(3) 本次交易的原因及必要性

上市公司是国际知名专业自动化称重计量设备生产制造企业，拥有完整的研发、制造、销售和服务体系，致力于提供专业化、高性能的计量称重设备和解决方案。为进一步提升公司综合能力和公司竞争力，立足于未来发展战略布局的考虑，公司在发展主营业务的同时，也一直在对其他不同领域业务进行积极探索。

本次交易是公司对其他不同领域业务的积极尝试和探索，符合公司战略转型的需要，同时也是公司主营业务之外的有益补充，有利于优化上市公司业务结构，进一步扩大上市公司资产规模，从而提升上市公司综合竞争能力，增强抗风险能力和可持续发展能力，具有合理性和必要性。

问题5. 请补充说明标的公司管理团队情况，收购完成后管理团队稳定性，是否对关键管理人员存在重大依赖，是否签署必要的劳动协议、竞业禁止协议等。

回复：

(1) 标的公司管理团队情况

根据成都高新区市场监督管理局提供的企业工商档案及《成都芯通软件有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关约定，截至本回复出具之日，标的公司的董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	选举或聘任程序
1	李睿	执行董事、总经理	执行董事由投资者委派；总理由执行董事聘任
2	蔡翔	监事	股东会选举或更换

标的公司按照《中华人民共和国公司法》和公司章程设置执行董事一位（未设置董事会）、设监事一名（未设置监事会），李睿在标的公司任执行董事兼总经理职务；

根据公司章程的相关约定：

（1）标的公司设立执行董事，执行董事是标的公司的最高权力机构。标的公司首届执行董事为李睿。执行董事任期3年，经投资者委派可继续连任。

（2）标的公司设监事一名（注：或两名）。股东代表出任的，由股东会选举或更换；职工代表出任的，由公司职工通过职工大会（或职工代表大会）民主选举产生。监事任期每届为三年。监事任期届满，选举可以连任。

（3）标的公司实行执行董事领导下的总经理负责制，标的公司设总经理一名、副总经理一名。总经理、副总经理由执行董事聘任，任期3年，可连聘连任。

除上述执行董事、监事外，标的公司设有首席运营官1名、财务总监1名、副总经理5名，共同构成标的公司的核心管理团队。

标的公司核心管理团队情况如下：

姓名	职务	个人简历
李睿	执行董事、总经理	男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。李睿先生自1990年9月至2001年1月，于北京中龙有限公司产品部任产品副总裁；2001年1月至2004年9月，于飞博创（成都）科技有限公司任执行副总裁；2004年9月至2012年3月，于芯通科技（成都）有限公司任总裁；自标的公司成立至今，于标的公司任执行董事兼总经理。

姓名	职务	个人简历
魏斌	首席运营官、 副总经理	男，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。魏斌先生自1995年7月至2000年12月，于核工业西南物理研究院任工程师；2001年3月至2007年7月，于飞博创（成都）科技有限公司任高级总监；2007年7月至2009年3月，于索尔思光电（成都）有限公司任高级总监；2010年10月至2012年2月，于芯通科技（成都）有限公司运营部任副总裁；2012年2月至2014年12月，于芯通科技任运营部副总裁；2014年12月至2016年，于芯通科技任副总经理。2016年至2019年4月，任职芯通科技首席运营官，2019年4月至今，任职标的公司首席运营官。
王怡虹	财务总监	女，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。王怡虹女士自1992年7月至2000年12月，于北京宝树堂制药有限公司财务部任会计；2001年3月至2008年6月，于飞博创（成都）科技有限公司财务部任财务经理；2008年6月至2012年2月，于芯通科技（成都）有限公司财务部任财务经理；2012年2月至2014年11月，于芯通科技财务部任财务经理。2014年12月至2019年4月，于芯通科技任财务总监。2019年4月至今，任职标的公司财务总监。
赵聪平	副总经理	男，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。赵聪平先生自1986年9月至1998年5月，于国营成都电视设备厂CA TV设计所任工程师；1998年5月至2000年12月，于四川中龙现代集成工程有限公司任产品经理；2000年12月至2007年5月，于飞博创（成都）科技有限公司任华东区域销售总监；2007年5月至2012年2月，于芯通科技（成都）有限公司任华东区域销售总监；2012年3月至2013年3月，于芯通科技任华东区域销售总监；2013年3月至2016年3月，于芯通科技任副总经理。2016年3月至2018年3月，任职芯通科技运营副总裁，2018年4月到2019年3月，任职芯通科技销售副总裁，2019年4月至今，任职标的公司的销售副总裁。
张兵	副总经理	男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张兵先生系功放行业资深人士，拥有一项发明专利，曾担任多项省（市）专项项目和两项国家重点专项项目技术负责人。张兵先生自2000年7月至2005年2月，于飞博创（成都）科技有限公司研发部任工程师；2005年3月至2012年2月，于芯通科技（成都）有限公司研发部历任工程师、研发经理、研发总监；2012年2月至2014年12月，于芯通科技任研发总监；2014年12月至2016年3月，于芯通科技任副总经理。2016年3月至2019年3月，任职芯通科技研发副总裁，2019年4月至今，任职标的公司的研发副总裁。

姓名	职务	个人简历
李小平	副总经理	男，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。李小平先生自1996年7月至2001年10月，于成都旭光科技股份有限公司设计所任设计师；2005年5月至2012年2月，于芯通科技（成都）有限公司历任工程师、研发经理、产品经理；2012年3月至2019年2月，于芯通科技任产品总监、事业部总经理、市场部总经理；2019年4月至今，任职标的公司的市场副总裁。
王斌	副总经理	男，1977年5月12日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年毕业于中国电子科技大学，硕士学历，曾多次参加省（市）及国家专项项目，拥有发明专利四项。2000年7月至2003年4月，任职于中国电子科技集团第四十一研究所，担任研发助理工程师，参与微波合成信号源研发工作；2007年至2021年1月，在芯通科技和标的公司主导射频系统的研发。2018年10月至2021年1月，任职标的公司系统产品部研发总监，2021年2月至今，任职标的公司运营副总裁。

（2）收购完成后管理团队稳定性，是否对关键管理人员存在重大依赖、是否签署必要的劳动协议、竞业禁止协议

为保证管理团队的稳定性，成都芯通科技股份有限公司设立了两家员工持股平台持有成都芯通科技股份有限公司的股份，分别为成都芯芯企业管理合伙企业（有限合伙）、成都创芯佳企业管理合伙企业（有限合伙）。标的公司的管理团队在员工持股平台中的持股情况如下：

姓名	职务	在员工持股平台中的持股情况
李睿	执行董事、总经理	持有成都芯芯 5.36% 出资份额，持有成都创芯佳 20.02% 出资份额
魏斌	首席运营官、副总经理	持有成都创芯佳 11.81% 出资份额
王怡虹	财务总监	持有成都创芯佳 5.09% 出资份额
赵聪平	副总经理	持有成都芯芯 9.98% 出资份额
张兵	副总经理	持有成都创芯佳 5.27% 出资份额
李小平	副总经理	持有成都创芯佳 3.82% 出资份额
王斌	副总经理	持有成都创芯佳 4.43% 出资份额

标的公司的核心管理团队人员中，李睿的社保和公积金均在标的公司处缴纳，其他人员均与标的公司签署了《劳动合同书》，其中第十七条约定：“乙方（劳动者）在甲方（标的公司）工作期间，掌握公司的专有技术，因合同到期、解除

劳动合同或其他原因离开公司后两年内，不得到与甲方生产相同或类似产品或经营相同或类似业务和或具有竞争关系的其他用人单位工作，也不得自己生产与甲方有竞争关系的同类产品或经营同类业务”。因劳动合同中就竞业限制作了明确的约定，标的公司未与前述管理团队人员另行签署竞业限制协议。

根据上述内容，目前标的公司的核心管理团队人员均已参股了上述两家员工持股平台，本次投资完成后，两家员工持股平台将成为标的公司的直接持股股东，与标的公司形成深度绑定，管理团队稳定。此外，标的公司与上述管理团队人员均签署了劳动合同并就竞业限制作了明确的约定，该等安排有助于维护管理团队的稳定性。

本次交易是公司的一项对外投资行为，交易完成后标的公司将成为公司的参股子公司，公司将向标的公司委派一名董事。本次投资前后，标的公司的管理团队人员在标的公司的任职均不发生改变，本次投资不会影响管理团队的稳定性。标的公司上述管理人员均由明确的选任聘任程序进行选任或聘任，标的公司对关键管理人员不存在重大依赖。

综上，本次投资完成后，标的公司的管理团队能够保持稳定，标的公司对关键管理人员不存在重大依赖，标的公司已与关键管理人员签署必要的劳动协议并就竞业限制作了明确的约定。

评估师及会计师均已正式进场芯通软件开展评估和审计工作，截至目前尚未完成相关工作，亦未出具正式的评估和审计报告，由于《关注函》中问题2和问题3内容中介机构正在核查中，公司暂时无法披露中介机构的核查意见。待评估和审计报告正式出具后，公司将对相关内容进行补充。同时，公司也将根据此次交易的进展情况，履行相关的信息披露义务。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2021年10月15日